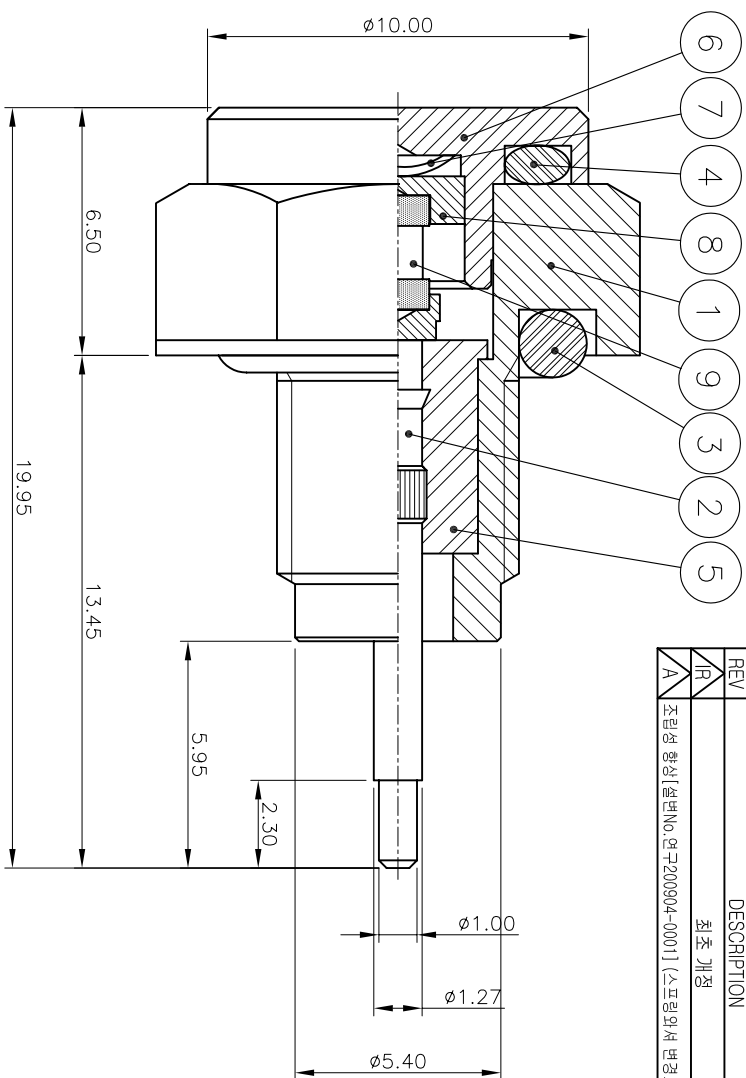


REVISION		
REV	DESCRIPTION	DATE
1	최초 개정	2009. 01. 09.
A	조립성 향상[플랜(No.연+200904-0001)] (스프링와셔 변경으로 인한 내부변경)	2009. 04. 01.



* ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range : DC ~ 3GHz
Impedance : 50Ω
Power : 1W

- * 조립 주의
1. BODY에 5번 INSULATOR를 조립 한다.
 2. INSULATOR 에 2번 PIN을 조립 한다.
 3. COVER에 4번 GASKET을 조립한다.
 4. COVER에 7번 SPRING RING을 삽입 후, 8번 INSERT를 삽입 한다.
 5. 위 4번 조립품에 9번 RESISTOR 을 삽입한다. (삽입 후 동작 확인)
 6. 위 조립 된 COVER와 BODY를 억지끼움 한다.
 7. 7번 GASKET을 조립한다.
 8. 멀티 미터기로 손수 저항 값을 확인 한다.
(47~53 Ω)

9	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
8	INSERT	1	MBSBD	Nickel Plate	DIS00134-5/1
7	SPRING WASHER	1	BeCu	Silver Plate	DWA00093-5/1
6	COVER	1	MBSBD	Nickel Plate	DCV00060-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON	White	DIN01452-N/1
4	GASKET	1	NBR	Black(AN-010)	DGK00023-N/1 (G2004)
3	GASKET	1	SILICONE RUB	Red (S-06)	DGK00020-N/1 (G2008)
2	CONTACT	1	MBSBD	Gold Plate	DCT01817-5/1
1	BODY	1	MBSBD	Nickel Plate	DBD02278-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	±0.1
	Angle	±1°
APPROVED BY		S.J.YOUN
CHECKED BY		I.C.KIM
DRAWN BY		E.H.KIM
FINISH	-	
SCALE	5/1	UNIT
	mm	
TITLE		ENTRY 50Ω INSERT TERM (1W)
DWG NO.		TM00004-7/2
REVISION		A
SHEET		1 of 1